

## 英飞凌 MOSFET

PG-HDSOP-22

### 600V CoolMOS™ SJ S7A 功率器件

CoolMOS™ S7T 为低频开关应用实现了最佳的性价比。嵌入式温度传感器提高了结温传感的准确性和稳健性，同时保持了简单、无缝的实施。CoolMOS™ S7T 针对“静态开关”和大电流应用进行了优化。新的温度传感器增强了 S7 的功能，可以最大限度地利用功率晶体管。

### 特性

- 低频开关应用的最佳性价比
- 高脉冲电流能力
- 最低系统的无缝诊断
- 温度感应功能可提供保护并优化热设备利用成本

### 优点

- 与机电设备相比，减少了外部传感元件，因此设计更加紧凑
- 提高了系统性能
- 最小化传导损耗（消除/减少散热器）
- 提高了系统性能
- 更紧凑、更直接的设计
- 在更长的使用寿命内降低 BOM 或/和 TCO
- 更高的可靠性和更长的系统寿命

### 潜在应用

- 固态继电器和断路器（PLC、储能器）
- 高功率/性能应用中的线路整流，例如计算、电信、UPS 和太阳能

### 产品验证

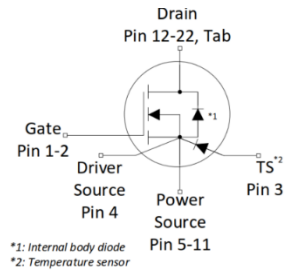
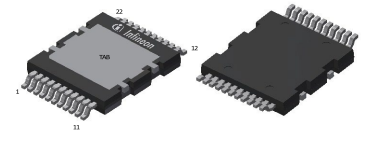
完全符合 JEDEC 工业应用标准

请注意：源和感测源引脚不可互换。它们的交换可能会导致故障。对于并联 4 引脚 MOSFET 器件，通常建议将栅极电阻放置在驱动源上而不是栅极上。

表 1 主要性能参数

Parameter	Value	Unit
$R_{DS(on),max}$	10	mΩ
$Q_{g,typ}$	318	nC
$V_{SD}$	0.82	V
Pulsed $I_{SD}, I_{DS}$	796	A
ESD class (HBM)	2	JEDEC JS-001

Type/Ordering Code	Package	Marking	Related Links
IPDQ60T010S7	PG-HDSOP-22	60I010S7	see Appendix A





## 目录

描述.....	1
最大额定值 .....	3
热特性.....	4
电气特性 .....	5
温度传感器参数.....	7
电气特性图.....	8
测试电路 .....	12
封装外形 .....	13
附录 A.....	16
修订记录 .....	17
商标.....	17
免责声明.....	17

## 1 最大额定值

$T_f=25\text{ °C}$ , 除非另有规定

表 2 最大 MOSFET 额定值

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note/ Test Condition
		Min.	Typ.	Max.		
Drain current rating <sup>1)</sup>	$I_D$	-	-	174 50	A	$T_C=25\text{ °C}$ $T_C=140\text{ °C}$
Pulsed drain current <sup>2)</sup>	$I_{D,pulse}$	-	-	796	A	$T_C=25\text{ °C}$
Avalanche energy, single pulse	$E_{AS}$	-	-	612	mJ	$I_D=6.3\text{ A}$ ; $V_{DD}=50\text{ V}$ ; see table 11
Avalanche current, single pulse	$I_{AS}$	-	-	6.3	A	-
MOSFET dv/dt ruggedness <sup>3)</sup>	dv/dt	-	-	20	V/ns	$V_{DS}=0\text{ V to }300\text{ V}$
Gate source voltage (static)	$V_{GS}$	-20	-	20	V	static
Gate source voltage (dynamic)	$V_{GS}$	-30	-	30	V	AC ( $f>1\text{ Hz}$ )
Power dissipation	$P_{tot}$	-	-	694	W	$T_C=25\text{ °C}$
Storage temperature	$T_{stg}$	-55	-	150	°C	-
Operating junction temperature <sup>1)</sup>	$T_j$	-55	-	150	°C	-
Extended operating junction temperature	$T_j$	150	-	175	°C	$\leq 50\text{ h}$ in the application lifetime
Mounting torque	-	-	-	n.a.	Ncm	-
Diode forward current rating	$I_S$	-	-	50	A	$T_C=140\text{ °C}$ Current is limited by $T_{j,max} = 150\text{ °C}$ ; Lower case temp does increase current capability
Diode pulse current <sup>1)</sup>	$I_{S,pulse}$	-	-	796	A	$T_C=25\text{ °C}$
Reverse diode dv/dt <sup>4)</sup>	dv/dt	-	-	5	V/ns	$V_{DS}=0\text{ to }300\text{ V}$ , $I_{SD}\leq 50\text{ A}$ , $T_j=25\text{ °C}$ see table 9
Maximum diode commutation speed	$di_f/dt$	-	-	800	A/ $\mu\text{s}$	$V_{DS}=0\text{ to }300\text{ V}$ , $I_{SD}\leq 50\text{ A}$ , $T_j=25\text{ °C}$ see table 9
Insulation withstand voltage	$V_{ISO}$	-	-	n.a.	V	-

1) 请考虑应用说明：600V CoolMOSTM S7 带有温度感应功能，适用于高  $\Delta T_j$  用途

2) 脉冲宽度  $t_p$  受限于  $T_{j,max}$

3) dv/dt 必须通过适当的栅极电阻来限制

4) 相同的低压侧和高压侧开关

## 2 热特性

表 3 热特性

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note/ Test Condition
		Min.	Typ.	Max.		
Thermal resistance, junction - case	$R_{thJC}$	-	-	0.18	°C/W	-
Thermal resistance, junction - ambient	$R_{thJA}$	-	-	62	°C/W	device on PCB, minimal footprint
Thermal resistance, junction - ambient for SMD version	$R_{thJA}$	-	45	55	°C/W	Device on 40mm*40mm*1.5mm epoxy PCB FR4 with 6cm <sup>2</sup> (one layer, 70μm thickness) copper area. Tap exposed to air. PCB is vertical without air stream cooling.
Soldering temperature, reflow soldering allowed	$T_{sold}$	-	-	260	°C	reflow MSL1

### 3 电气特性

$T_j=25^\circ\text{C}$ , 除非另有规定

表 4 静态特性

对于施加阻断电压 $>420\text{V}$ 的应用, 要求客户在早期设计阶段评估宇宙辐射效应的影响, 并联系英飞凌销售办事处以获得英飞凌必要的技术支持

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note/ Test Condition
		Min.	Typ.	Max.		
Drain-source breakdown voltage	$V_{(BR)DSS}$	600	-	-	V	$V_{GS}=0\text{V}, I_D=1\text{mA}$
Gate threshold voltage	$V_{(GS)th}$	3.5	4.0	4.5	V	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=3.06\text{mA}$
Zero gate voltage drain current <sup>5)</sup>	$I_{DSS}$	-	- 80	8	$\mu\text{A}$	$V_{DS}=600\text{V}, V_{GS}=0\text{V}, T_j=25^\circ\text{C}$ $V_{DS}=600\text{V}, V_{GS}=0\text{V}, T_j=150^\circ\text{C}$
Gate-source leakage current	$I_{GSS}$	-	-	100	nA	$V_{GS}=20\text{V}, V_{DS}=0\text{V}$
Drain-source on-state resistance	$R_{DS(on)}$	-	0.01 0.022	0.010	$\Omega$	$V_{GS}=12\text{V}, I_D=50\text{A}, T_j=25^\circ\text{C}$ $V_{GS}=12\text{V}, I_D=50\text{A}, T_j=150^\circ\text{C}$
Gate resistance	$R_G$	-	0.45	-	$\Omega$	$f=1\text{MHz}$ , open drain

<sup>5)</sup> 断开

表 5 动态特性

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note/ Test Condition
		Min.	Typ.	Max.		
Input capacitance	$C_{iss}$	-	11986	-	pF	$V_{GS}=0\text{V}, V_{DS}=300\text{V}, f=250\text{kHz}$
Output capacitance	$C_{oss}$	-	188	-	pF	$V_{GS}=0\text{V}, V_{DS}=300\text{V}, f=250\text{kHz}$
Effective output capacitance, energy related <sup>6)</sup>	$C_{o(er)}$	-	643	-	pF	$V_{GS}=0\text{V}, V_{DS}=0$ to 300V
Effective output capacitance, time related <sup>7)</sup>	$C_{o(tr)}$	-	5714	-	pF	$I_D=\text{constant}, V_{GS}=0\text{V}, V_{DS}=0$ to 300V
Output charge	$Q_{oss}$	-	1714	-	nC	$V_{GS}=0\text{V}, V_{DS}=0$ to 300V
Turn-on delay time	$t_{d(on)}$	-	32	-	ns	$V_{DD}=300\text{V}, V_{GS}=13\text{V}, I_D=50\text{A}, R_G=3\Omega$ ; see table 9
Rise time	$t_r$	-	12	-	ns	$V_{DD}=300\text{V}, V_{GS}=13\text{V}, I_D=50\text{A}, R_G=3\Omega$ ; see table 9
Turn-off delay time	$t_{d(off)}$	-	170	-	ns	$V_{DD}=300\text{V}, V_{GS}=13\text{V}, I_D=50\text{A}, R_G=3\Omega$ ; see table 9
Fall time	$t_f$	-	9	-	ns	$V_{DD}=300\text{V}, V_{GS}=13\text{V}, I_D=50\text{A}, R_G=3\Omega$ ; see table 9

<sup>6)</sup>  $C_{o(er)}$  是一个固定电容, 其储存能量与  $C_{oss}$  相同, 当  $V_{DS}$  从 0 上升至 300V

<sup>7)</sup>  $C_{o(tr)}$  是一个固定电容, 其充电时间与  $C_{oss}$  相同, 当  $V_{DS}$  从 0 上升至 300V

表 6 栅极电荷特性

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note/ Test Condition
		Min.	Typ.	Max.		
Gate to source charge	$Q_{gs}$	-	69	-	nC	$V_{DD}=300V, I_D=50A, V_{GS}=0$ to 12V
Gate to drain charge	$Q_{gd}$	-	105	-	nC	$V_{DD}=300V, I_D=50A, V_{GS}=0$ to 12V
Gate charge total	$Q_g$	-	318	-	nC	$V_{DD}=300V, I_D=50A, V_{GS}=0$ to 12V
Gate plateau voltage	$V_{plateau}$	-	5.7	-	V	$V_{DD}=300V, I_D=50A, V_{GS}=0$ to 12V

表 7 反向二极管特性

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note/ Test Condition
		Min.	Typ.	Max.		
Diode forward voltage	$V_{SD}$	-	0.82	-	V	$V_{GS}=0V, I_F=50A, T_j=25^\circ C$
Reverse recovery time	$t_{rr}$	-	600	-	ns	$V_R=300V, I_F=50A, di_F/dt=100A/\mu s$ ; see table 8
Reverse recovery charge	$Q_{rr}$	-	17	-	$\mu C$	$V_R=300V, I_F=50A, di_F/dt=100A/\mu s$ ; see table 8
Peak reverse recovery current	$I_{rrm}$	-	55	-	A	$V_R=300V, I_F=50A, di_F/dt=100A/\mu s$ ; see table 8

## 4 温度传感器参数

$T_j=25\text{ }^\circ\text{C}$ , 除非另有规定

表 8 最大额定值

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note/ Test Condition
		Min.	Typ.	Max.		
Repetitive Peak Reverse Voltage	$V_{RRM}$	-	-	15	V	$I_R = 100\ \mu\text{A}$
Sensor forward current	$I_F$	-	-	5	mA	-
Repetitive peak forward current	$I_{F\_pulse}$	-	-	25	mA	$t_{pulse} = 1\ \text{ms}$ , $T_{period} = 10\ \text{ms}$
Non-repetitive peak forward current	$I_{FSM}$	-	-	0.1	A	$T_C = 25^\circ\text{C}$ , $t_{pulse} = 1\ \text{s}$
Junction Temperature	$T_j$	-	-	185	$^\circ\text{C}$	$t < 50\text{h}$ , Sensor only

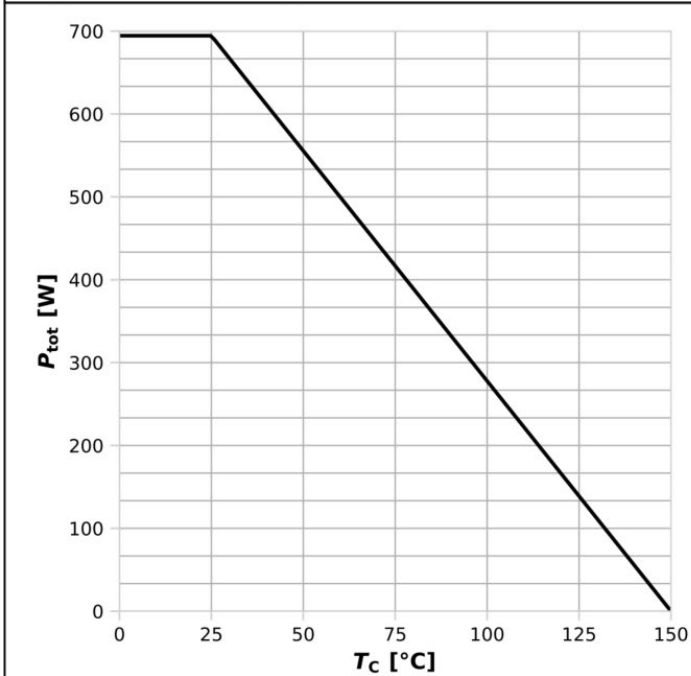
表 9 电气特性

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note/ Test Condition
		Min.	Typ.	Max.		
Sensor forward voltage <sup>8)</sup>	$V_{F\_25}$	1.5601	1.6019	1.6436	V	$T_j = 25^\circ\text{C}$ , $I_F = 10\ \mu\text{A}$
		-	1.8103	-		$T_j = 25^\circ\text{C}$ , $I_F = 50\ \mu\text{A}$
		-	1.9806	-		$T_j = 25^\circ\text{C}$ , $I_F = 200\ \mu\text{A}$
		2.0665	2.0966	2.1266		$T_j = 25^\circ\text{C}$ , $I_F = 500\ \mu\text{A}$
Sensor forward voltage temperature coefficient	$TC$	-	5.0135	-	mV/K	$25^\circ\text{C} \leq T_j \leq 175^\circ\text{C}$ , $I_F = 500\ \mu\text{A}$
Sensor forward voltage	$V_{F\_175}$	1.3144	1.3445	1.3746	V	$T_j = 175^\circ\text{C}$ , $I_F = 500\ \mu\text{A}$
Reverse leakage current	$I_R$	-	-	20	$\mu\text{A}$	$V_R = 10\text{V}$ , $T_j = 175^\circ\text{C}$
Sensor G Capacitance	$C_{GTS}$	-	4.2	-	pF	$f = 1\ \text{MHz}$ , $I_F = 50\ \mu\text{A}$
Sensor Capacitance	$C_{STS}$	-	4.8	-	pF	$f = 1\ \text{MHz}$ , $I_F = 50\ \mu\text{A}$
Anode-Drain Capacitance	$C_{DTS}$	-	0.5	-	pF	$f = 1\ \text{MHz}$ , $V_{DS} = 0\ \text{V}$

<sup>8)</sup> 由设计定义, 未经测试

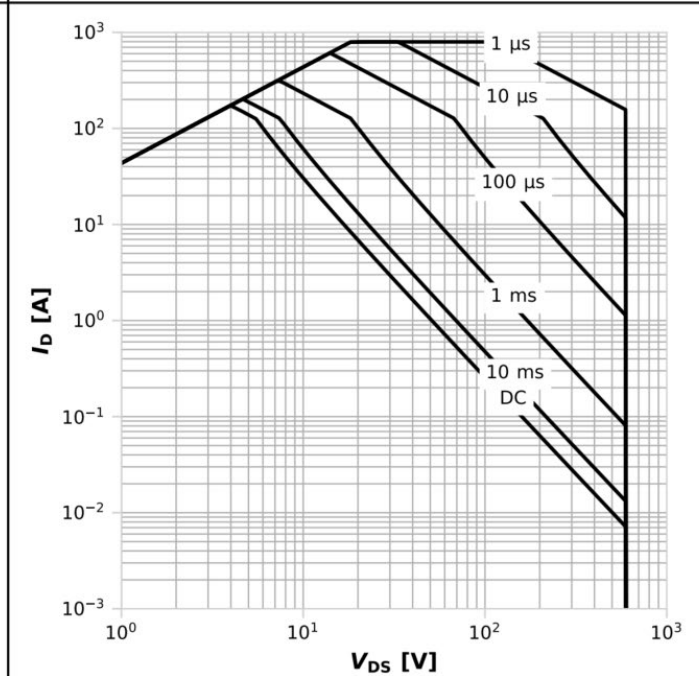
## 5 电气特性图

Diagram 1: Power dissipation



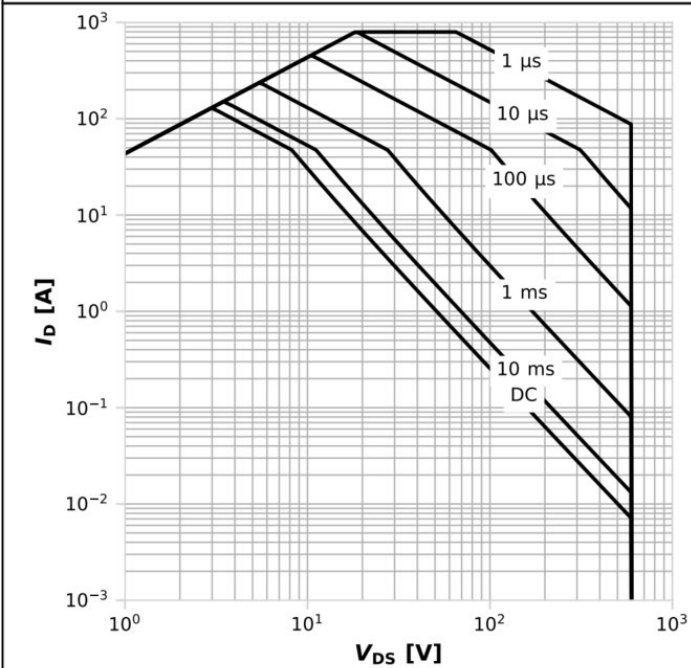
$$P_{tot}=f(T_c)$$

Diagram 2: Safe operating area



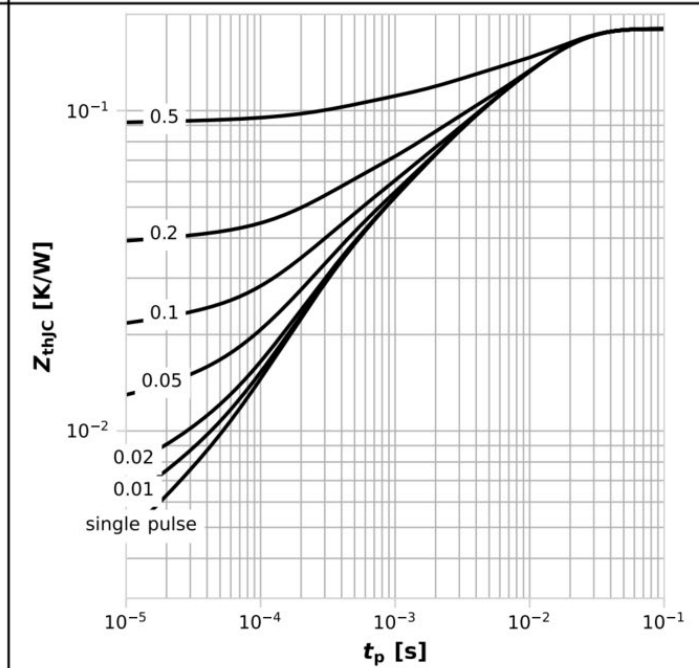
$$I_D=f(V_{DS}); T_c=25\text{ °C}; D=0; \text{parameter: } t_p$$

Diagram 3: Safe operating area



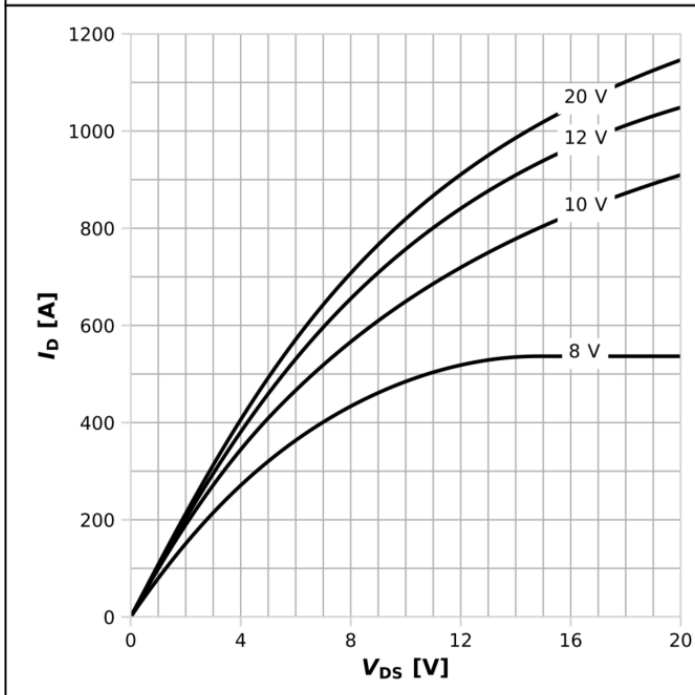
$$I_D=f(V_{DS}); T_c=80\text{ °C}; D=0; \text{parameter: } t_p$$

Diagram 4: Max. transient thermal impedance



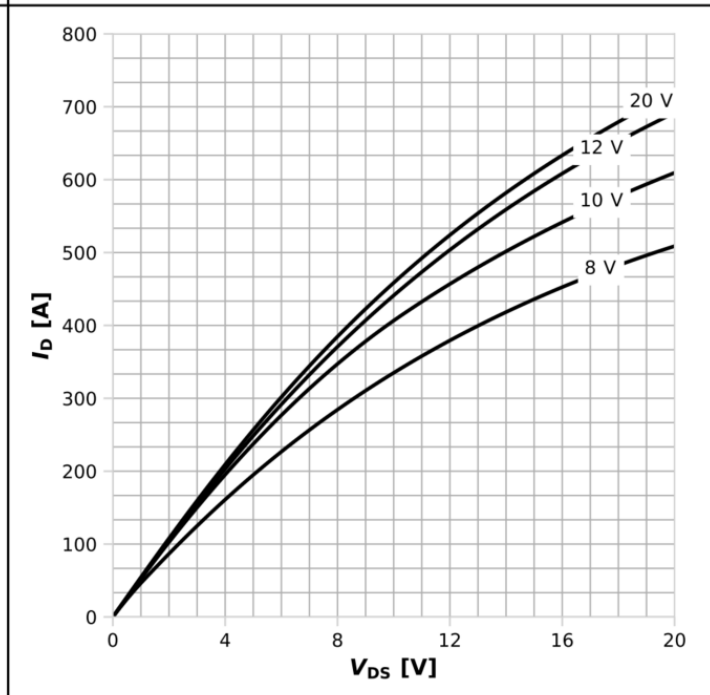
$$Z_{thjC}=f(t_p); \text{parameter: } D=t_p/T$$

Diagram 5: Typ. output characteristics



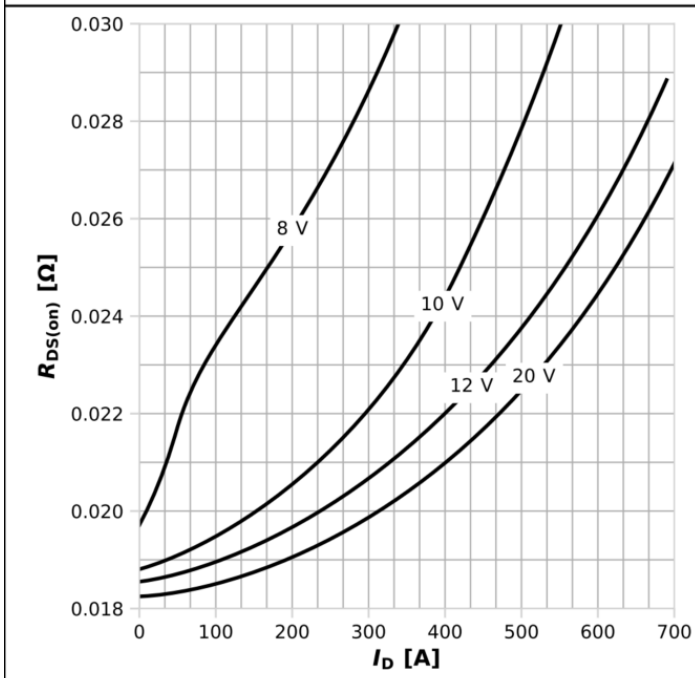
$$I_D = f(V_{DS}); T_j = 25 \text{ °C}; \text{parameter: } V_{GS}$$

Diagram 6: Typ. output characteristics



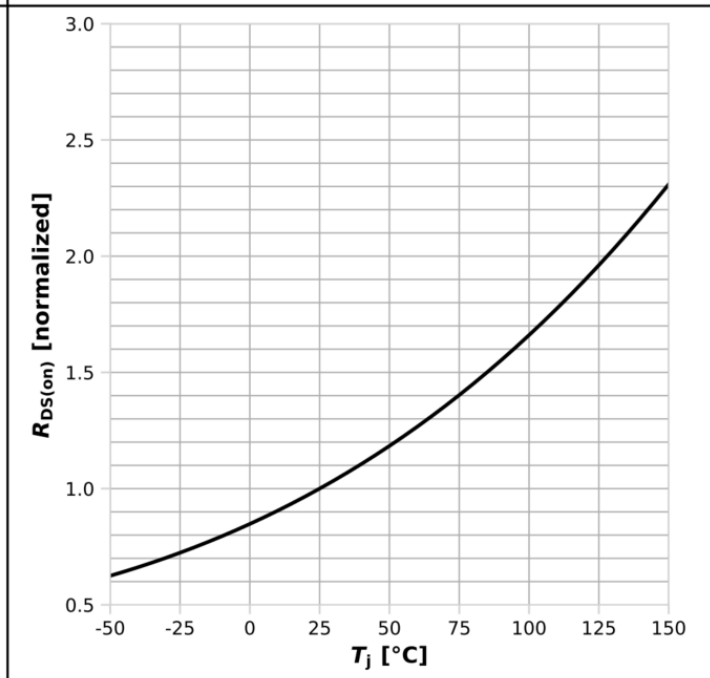
$$I_D = f(V_{DS}); T_j = 125 \text{ °C}; \text{parameter: } V_{GS}$$

Diagram 7: Typ. drain-source on-state resistance



$$R_{DS(on)} = f(I_D); T_j = 125 \text{ °C}; \text{parameter: } V_{GS}$$

Diagram 8: Drain-source on-state resistance



$$R_{DS(on)} = f(T_j); I_D = 50 \text{ A}; V_{GS} = 12 \text{ V}$$

Diagram 9: Typ. transfer characteristics

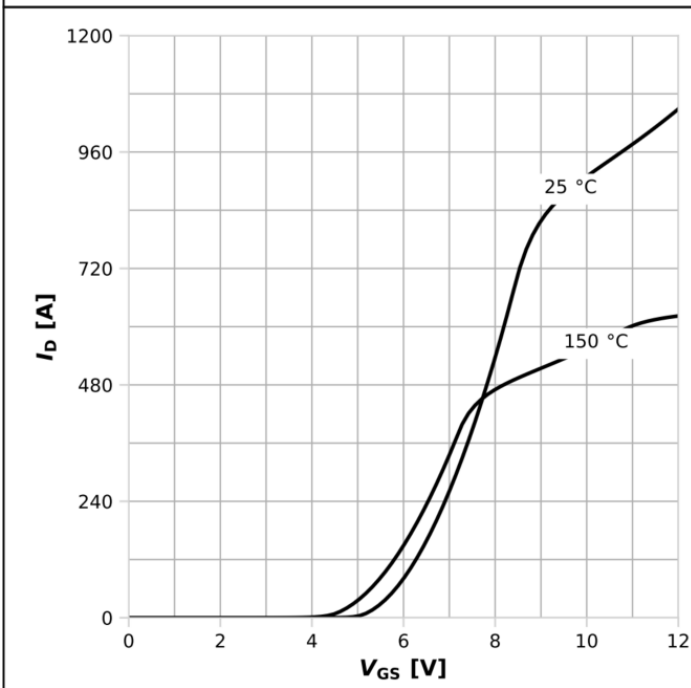

 $I_D = f(V_{GS}); V_{DS} = 20V; \text{parameter: } T_j$ 

Diagram 10: Typ. gate charge

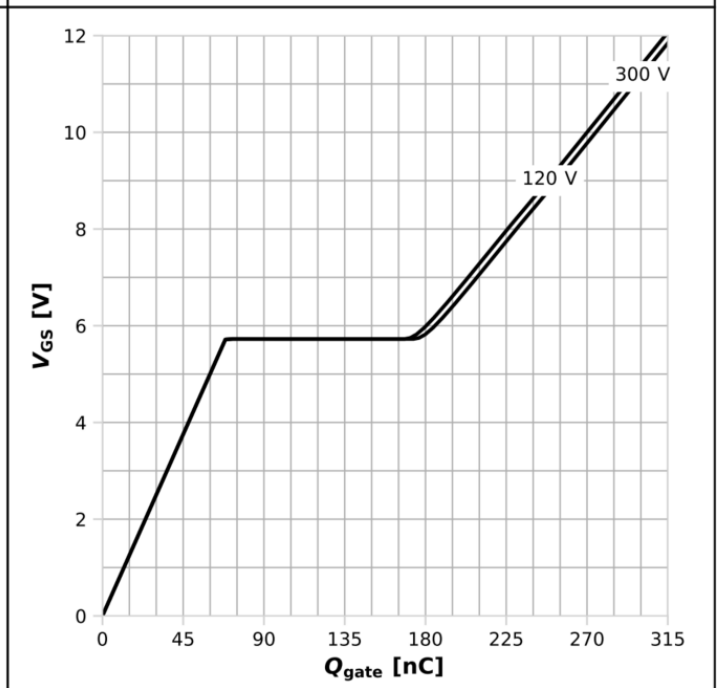

 $V_{GS} = f(Q_{gate}); I_D = 50 \text{ A pulsed}; \text{parameter: } V_{DD}$ 

Diagram 11: Forward characteristics of reverse diode

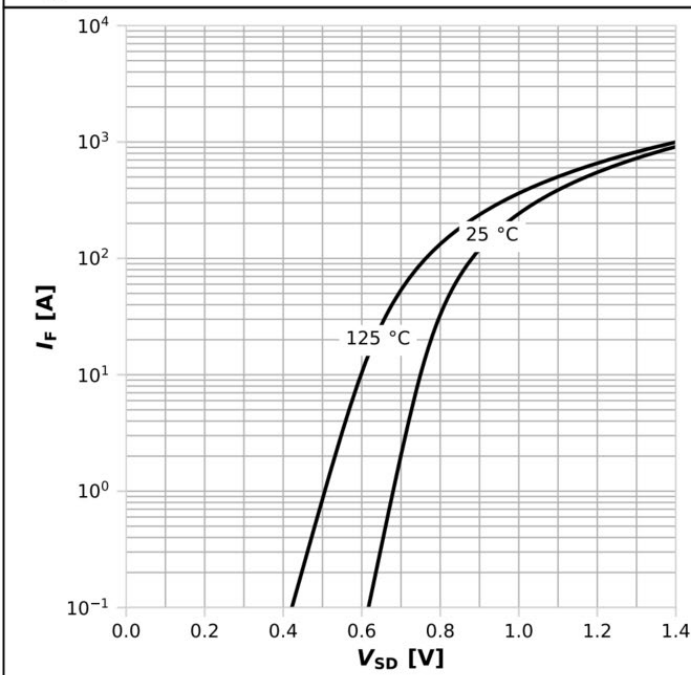

 $I_F = f(V_{SD}); V_{GS} = 0 \text{ V}; \text{parameter: } T_j$ 

Diagram 12: Forward characteristics of reverse diode

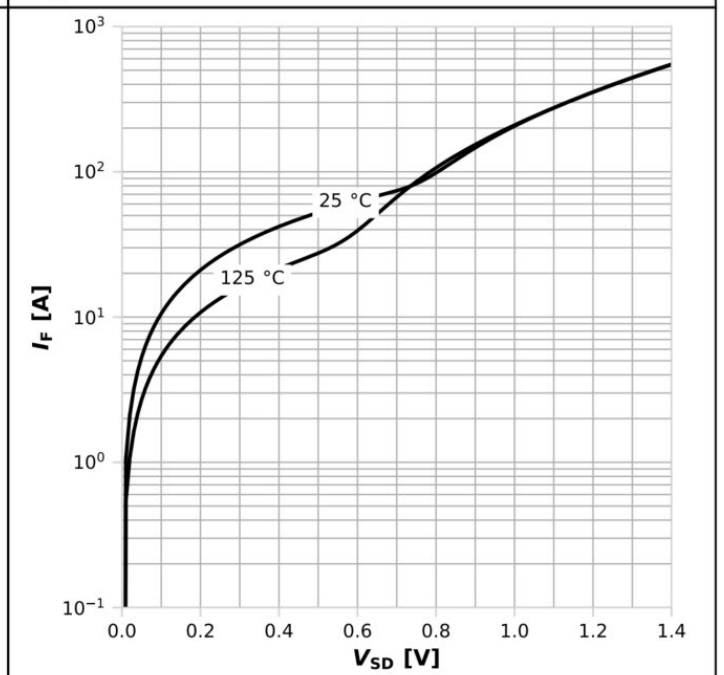
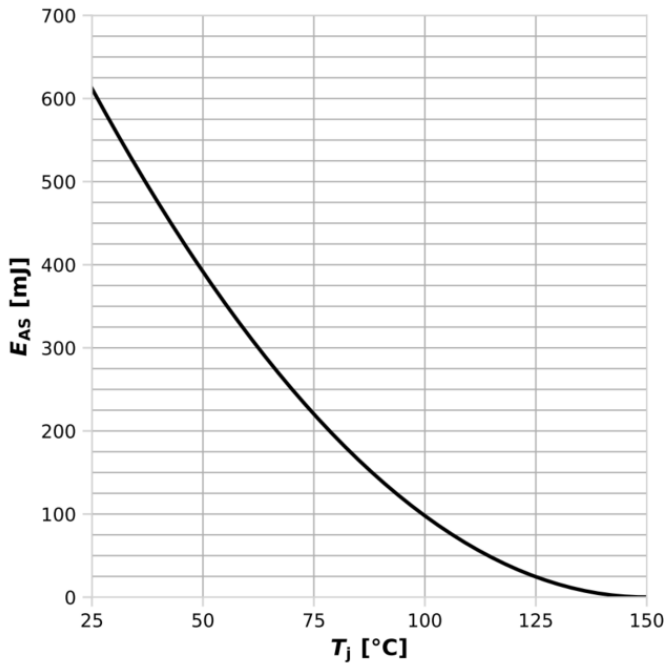
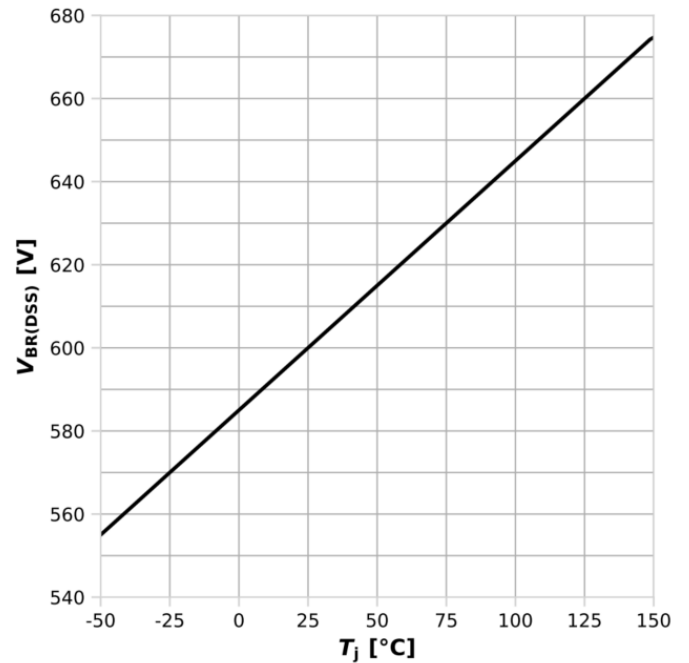

 $I_F = f(V_{SD}); V_{GS} = 12 \text{ V}; \text{parameter: } T_j$

Diagram 13: Avalanche energy



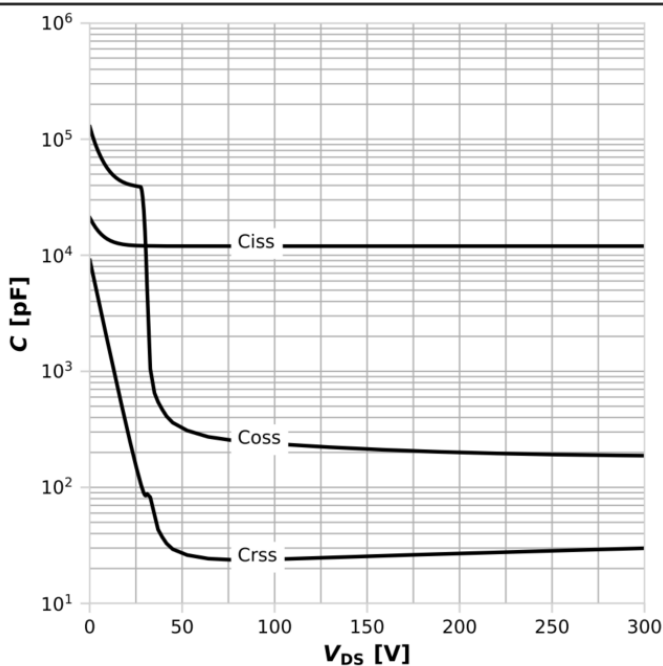
$$E_{AS}=f(T_j); I_D=6.3 \text{ A}; V_{DD}=50 \text{ V}$$

Diagram 14: Drain-source breakdown voltage



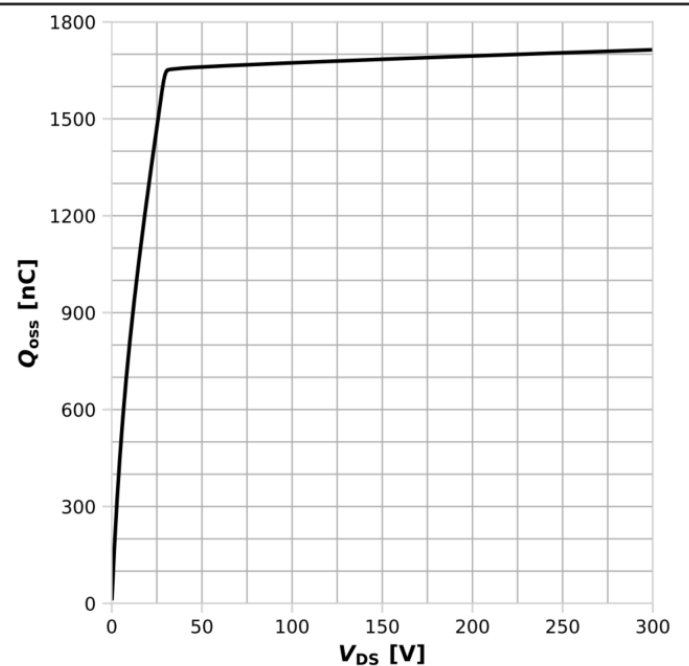
$$V_{BR(DSS)}=f(T_j); I_D=1 \text{ mA}$$

Diagram 15: Typ. capacitances



$$C=f(V_{DS}); V_{GS}=0 \text{ V}; f=250 \text{ kHz}$$

Diagram 17: Typ. Q\_oss output charge



$$Q_{oss}=f(V_{DS}); V_{GS}=0 \text{ V}$$

## 6 测试电路

表10 反向二极管特性

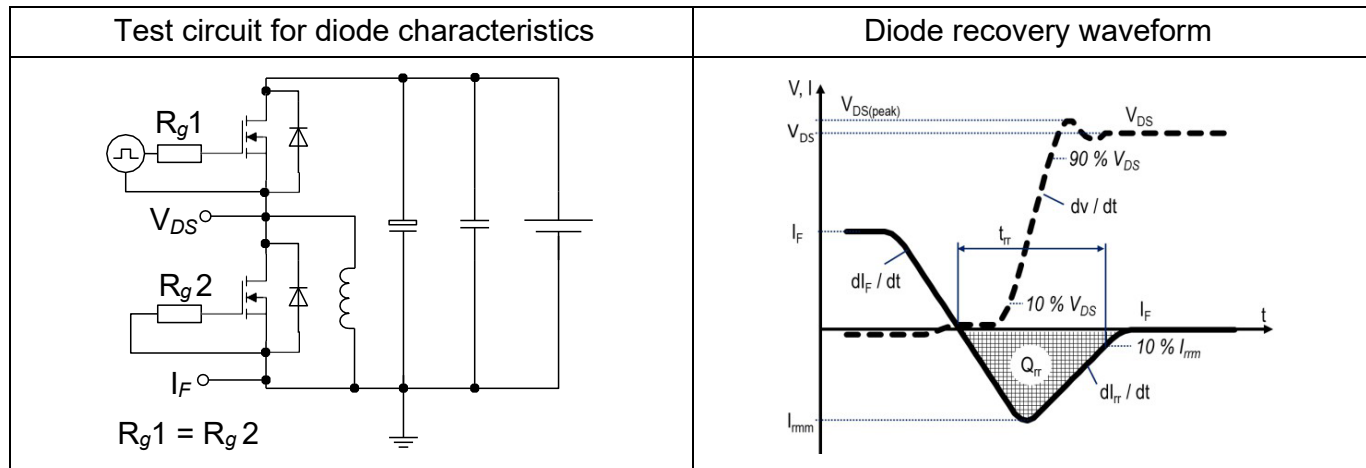


表 11 开关时间 (ss)

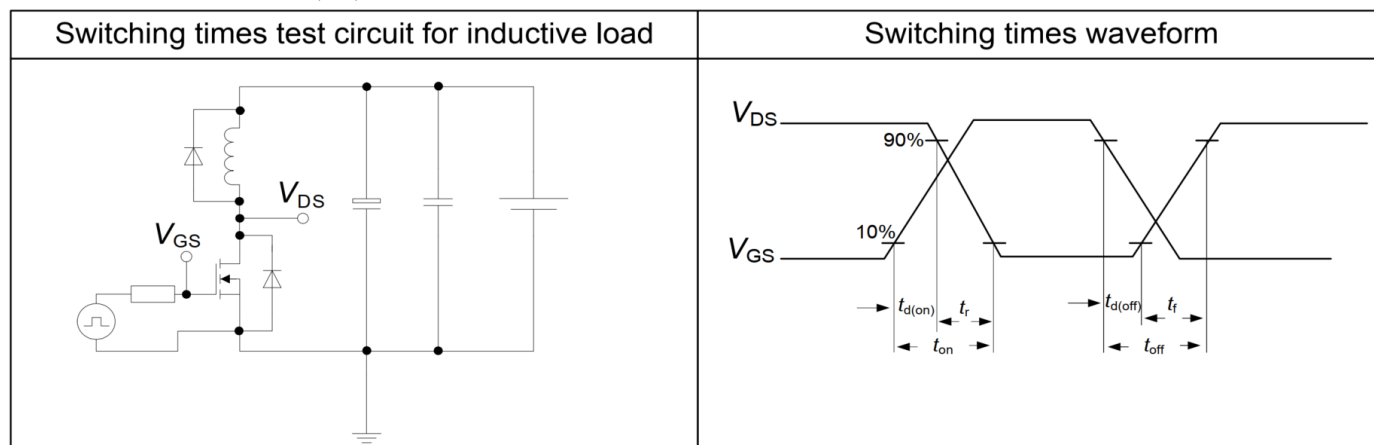
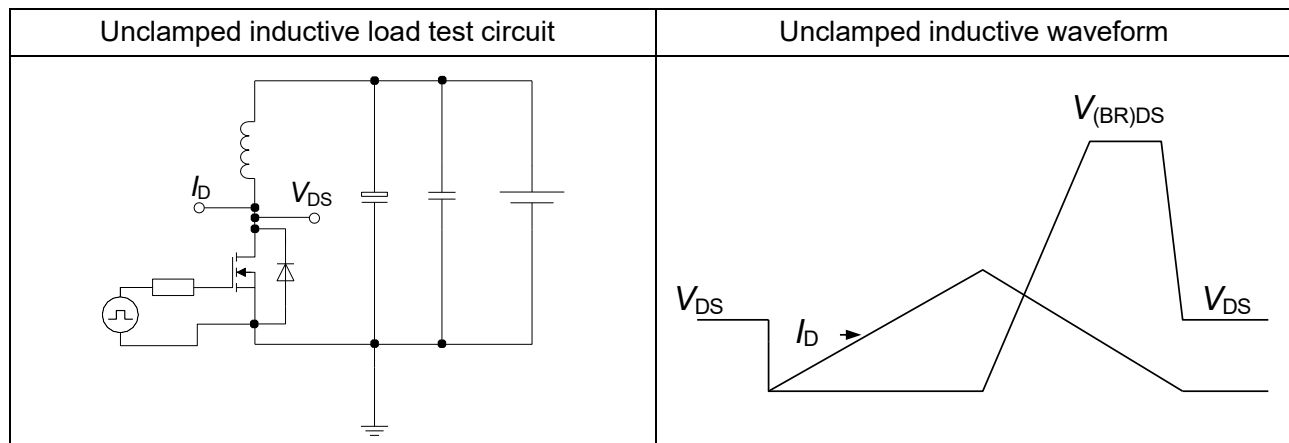


表 12 非钳位感性负载(ss)



## 7 封装外形

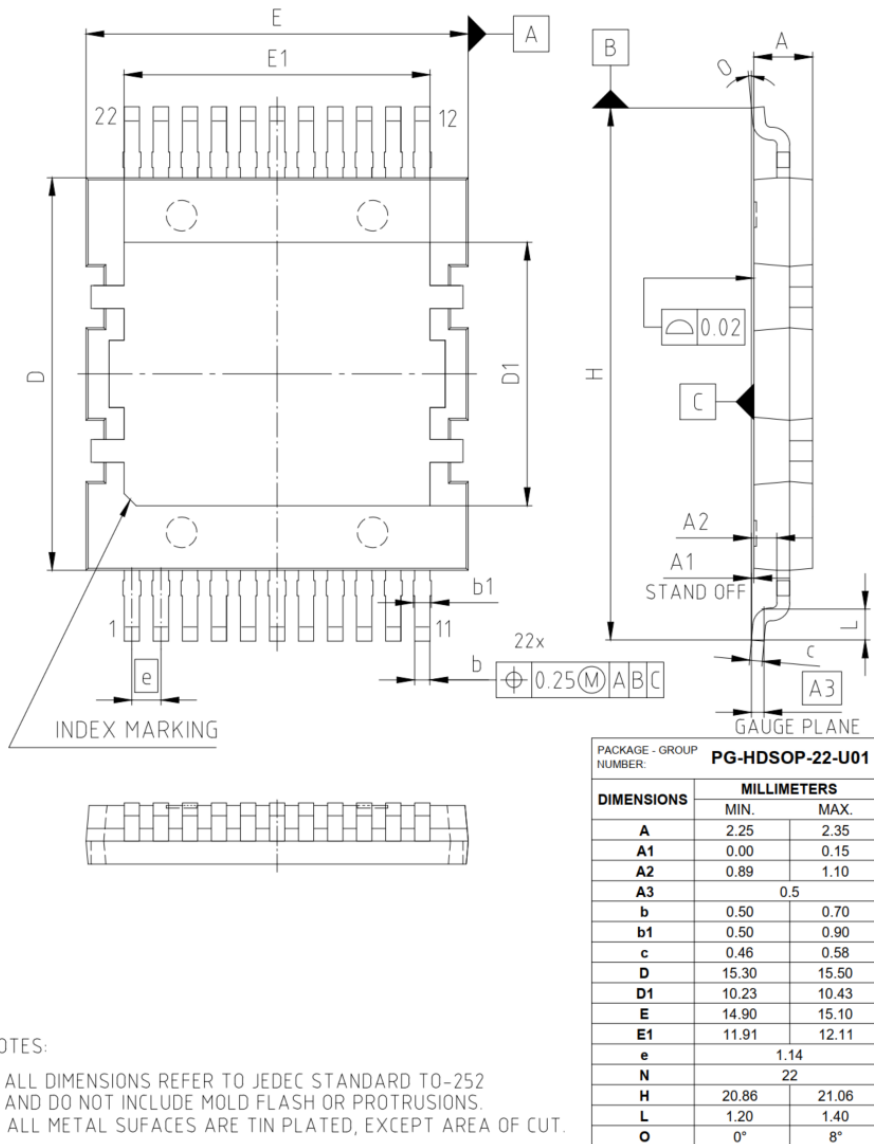


图 1 PG-HDSOP-22 外形图，尺寸单位为毫米

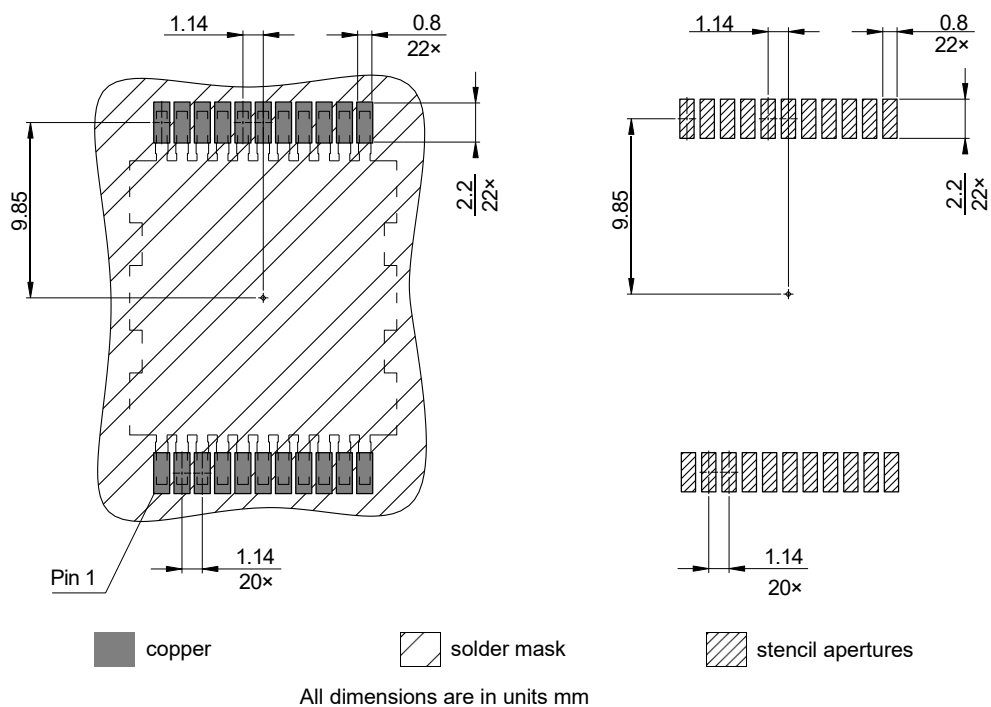


图 2 PG-HDSOP-22 外形图，尺寸单位为毫米

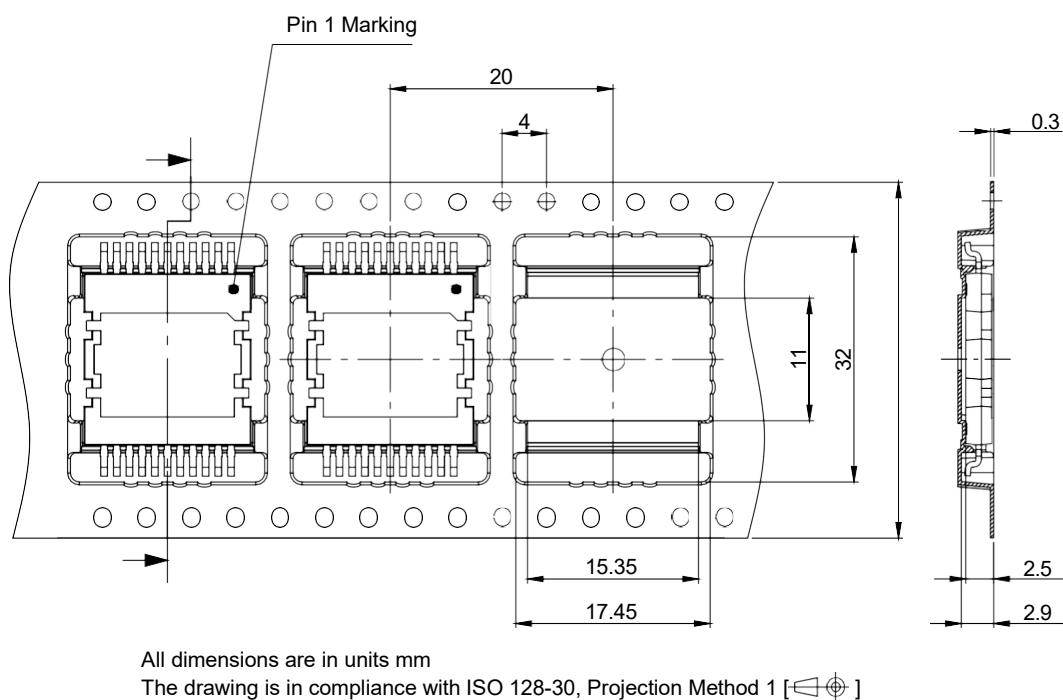


图 3 PG-HDSOP-22 外形图，尺寸单位为毫米

## 8 附录 A

表 13 相关链接

- [IFX CoolMOS™ S7T 网页](#)
- [IFX CoolMOS™ S7T 应用笔记](#)
- [IFX CoolMOS™ S7T 仿真模型](#)
- [IFX 设计工具](#)

## 修订记录

IPDQ60T010S7

**Revision 2024 - 05 - 24 , Rev. 2 . 1**

### 历史修订版本

Revision	Date	Subjects (major changes since last revision)
2.0	2024-03-21	Release of final version
2.1	2024-05-24	Update of Tc for drain and diode forward current

### 商标

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

**We Listen to Your Comments** Any information within this document that you feel is wrong, unclear or missing at all? Your feedback will help us to continuously improve the quality of this document. Please send your proposal (including a reference to this document) to: [erratum@infineon.com](mailto:erratum@infineon.com)

### Published by

**Infineon Technologies AG**  
**81726 München, Germany**  
© 2024 Infineon Technologies AG All  
Rights Reserved.

### Legal Disclaimer

The information given in this document shall in no event be regarded as a guarantee of conditions or characteristics ("Beschaffenheitsgarantie"). With respect to any examples, hints or any typical values stated herein and/or any information regarding the application of the product, Infineon Technologies hereby disclaims any and all warranties and liabilities of any kind, including without limitation warranties of non-infringement of intellectual property rights of any third party.

In addition, any information given in this document is subject to customer's compliance with its obligations stated in this document and any applicable legal requirements, norms and standards concerning customer's products and any use of the product of Infineon Technologies in customer's applications.

The data contained in this document is exclusively intended for technically trained staff. It is the responsibility of customer's technical departments to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product information given in this document with respect to such application.

### Information

For further information on technology, delivery terms and conditions and prices please contact your nearest Infineon Technologies Office ([www.infineon.com](http://www.infineon.com)).

### Warnings

Due to technical requirements, components may contain dangerous substances. For information on the types in question, please contact the nearest Infineon Technologies Office.

The Infineon Technologies component described in this Data Sheet may be used in life-support devices or systems and/or automotive, aviation and aerospace applications or systems only with the express written approval of Infineon Technologies, if a failure of such components can reasonably be expected to cause the failure of that life-support, automotive, aviation and aerospace device or system or to affect the safety or effectiveness of that device or system. Life support devices or systems are intended to be implanted in the human body or to support and/or maintain and sustain and/or protect human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user or other persons may be endangered.



## 免责声明

请注意，本文件的原文使用英文撰写，为方便客户浏览英飞凌提供了中文译文。该中文译文仅供参考，并不可作为任何论点之依据。

由于翻译过程中可能使用了自动化程序，以及语言翻译和转换过程中的差异，最后的中文译文与最新的英文版本原文含义可能存在不尽相同之处。

因此，我们同时提供该中文译文版本的最新英文原文供您阅读，请参见 <http://www.infineon.com>

英文原文和中文译文版本之间若存有任何歧异，以最新的英文版本为准，并且仅认可英文版本为正式文件。

**您如果使用本文件，即表示您同意并理解上述说明。英飞凌不对因翻译过程中可能存在的任何不完整或不准确信息而产生的任何直接或间接损失或损害负责。英飞凌不承担中文译文版本的完整性和准确性责任。如果您不同意上述说明，请不要使用本文件。**

## Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

## 重要通知

**Infineon Technologies AG** 及其关联公司（以下简称“英飞凌”）销售或提供和交付的产品（可能也包括样品，且可能由硬件或软件或两者组成）（以下简称“产品”），应遵守客户与英飞凌签订的框架供应合同或其他书面协议的条款和条件，如无上合同或其他书面协议，则应遵守适用的英飞凌销售条件。只有在英飞凌明确书面同意的情况下，客户的一般条款和条件或对适用的英飞凌销售条件的偏离才对英飞凌具有约束力。

为避免疑义，英飞凌不承担不侵犯第三方权利的所有保证和默示保证，例如对特定用途/目的的适用性或适销性的保证。

英飞凌对与样品、应用或客户对任何产品的具体使用有关的任何信息或本文件中给出的任何示例或典型值概不负责。

本文件中包含的数据仅供具有技术资格和技能的客户代表使用。客户有责任评估产品对预期应用和客户特定用途的适用性，并在预期应用和客户特定用途中验证本文件中包含的所有相关技术数据。客户有责任正确设计、编程和测试预期应用的功能性和安全性，并遵守与其使用相关的法律要求。

除非英飞凌另行明确批准，否则产品不得用于任何因产品故障或使用产品的任何后果可合理预期会导致人身伤害的应用。但是，上述规定并不妨碍客户在英飞凌明确设计和销售的使用领域中使用任何产品，但是客户对应用负有全部责任。

英飞凌明确保留根据适用法律，如《德国版权法》（UrhG）第 44b 条，将其内容用于商业资料和数据探勘（TDM）的权利。

如果产品包含安全功能：

由于任何计算设备都不可能绝对安全，尽管产品采取了安全措施，但英飞凌不保证产品不会被入侵、数据不会被盗或遗失，或不会发生其他漏洞（以下简称“安全漏洞”），英飞凌对任何安全漏洞不承担任何责任。

如果本文件包含或引用软件：

根据美国、德国和世界其他国家的知识产权法律和条约，该软件归英飞凌所有。英飞凌保留所有权利。因此，您只能按照软件附带的软件授权协议的规定使用本软件。

如果没有适用的软件授权协议，英飞凌特此授予您个人的、非排他性的、不可转让的软件知识产权授权（无权转授权）：(a) 对于以源代码形式提供的软件，仅在贵组织内部修改和复制该软件用于英飞凌硬件产品；及 (b) 对于以二进制代码 (binary code) 形式对外向终端用户分发该软件，仅得用于英飞凌硬件产品。禁止对本软件进行任何其他使用、复制、修改、翻译或编译。有关产品、技术、交货条款和条件以及价格的详细信息，请联系离您最近的英飞凌办公室或访问 <https://www.infineon.com>。

版本 2026-04-20

Infineon Technologies AG 出版，  
德国 Neubiberg 85579

版权 © 2025 Infineon Technologies AG  
及其关联公司。  
保留所有权利。

Do you have a question about this  
document?

Email:

[erratum@infineon.com](mailto:erratum@infineon.com)